

POKYNY PRO MONTÁŽ

S-BOARD FLOOR

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

Tento technologický postup slouží pro montáž systému S-BOARD FLOOR pro vytváření povrchové úpravy podlah v interiéru.

S-BOARD FLOOR

1. Podmínky pro provádění

- 1.1 Přípustná teplota podkladu a vzduchu během aplikace a zrání hmoty je +5°C až +30°C.
- 1.2 Nevyzrálé hmoty je nutné chránit před působením vody, mrazu a příliš rychlým vysycháním vlivem zvýšené teploty a nadměrného průvanu v interiéru.

2. Příprava podkladu

- 2.1 Vhodnými podklady jsou beton, deskové materiály na bázi dřeva, cementotřískové desky, sádrovlánité desky.
- 2.2 Podklad musí být čistý, zbavený prachu a mastnot, biologického napadení a soudržný – viz Příloha 1.
- 2.3 Doporučená hodnota soudržnosti podkladu je 0,2 MPa. Nesoudržná místa je potřeba odstranit a vyplnit vhodnou hmotou s požadovanou pevností v tlaku a přídržností minimálně 0,25 MPa.
- 2.4 Celoplošné srovnání podkladu lze provést vhodnou nivelační hmotou. Při zachování průměrných parametrů soudržnosti podkladu 0,2 MPa.
- 2.5 Soudržnost podkladu lze zvýšit nátěrem penetračním lakem EH.
- 2.6 Savé podklady se opatří penetračním nátěrem penetračním lakem EH dle příslušného technologického návodu.
- 2.7 Maximální odchylka rovinnosti nesmí přesahovat 5 mm / 2 m.

3. Lepení desek S-BOARD

- 3.1 Lepicí hmota se připravuje dle příslušného Technologického návodu.
- 3.2 Desky lze na požadovaný formát zaříznout nožem.
- 3.3 Přídržnost lepicí hmoty k podkladu je minimálně 0,2 MPa.
- 3.4 Původní dilatační spáry podkladu musejí být zachovány. Před započítím lepení se na těchto místech k podkladu připevní ukončovací a dilatační lišty. Kladou se do předem nanesené vrstvy lepicí hmoty.
- 3.5 Na připravený podklad se celoplošně natáhne zubovým hladítkem vrstva lepicí hmoty BETAFIX[®] SB, resp. BETAFIX[®] SF tak, aby se nanesená plocha minimálně rovnala ploše lepené desky.
- 3.6 Naformátované desky se rovnoměrně zatlačí do vrstvy předem nanesené lepicí hmoty, aby došlo k celoplošnému spojení desky s lepicí hmotou.
- 3.7 Desky se kladou na sraz, delší stranou na vazbu. Minimální přesah je 100 mm. Spára mezi deskami nesmí být vyplněna lepicí hmotou.
- 3.8 Desky lze do roviny srovnat pomocí vodováhy.

4. Kotvení desek

- 4.1 Kotvení desek se provádí po vytvrdnutí lepicí hmoty, nejdříve však po 24 hodinách.
- 4.2 Kotvení se provádí, pokud se desky lepí na objemově nestabilní nebo pružné podklady na bázi dřeva, pomocí kotvicích prvků tvořených podkladovým talířkem HA 36 (nerezové provedení) nebo TIT 60 a vhodným samořezným šroubem.
- 4.3 Minimální počet kotvicích prvků je 6 ks / desku.
- 4.4 Kotvy se kladou přibližně 20 až 50 mm od okraje desky v rozích a přibližně v polovině delšího rozměru desky.
- 4.5 Samořezný šroub se šroubuje pomocí příslušného nástavce na vrtačce nebo elektrickém šroubováku. Povrch talířku by měl celou plochou dolehnout k povrchu desky. Mírné zapuštění do desky není na závadu.

POKYNY PRO MONTÁŽ

S-BOARD FLOOR

Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

5. Úprava spár mezi deskami

- 5.1 Operace se provádí po vytvrnutí lepicí hmoty a případném kotvení desek kotvicími prvky. Nejdříve však 24 hodin po nalepení desek S-BOARD.
- 5.2 Spáry se upravují pomocí 100 mm širokých pásů skleněné síťoviny VT1/1 a stěrkové hmoty ALFAFIX[®] S1, případně BETAFIX[®] SF. Příprava hmot se řídí příslušnými Technologickými pokyny uvedených hmot.
- 5.3 Na desky se podél spáry nanese vrstva stěrkové nebo lepicí hmoty v šířce přibližně poloviny šířky skleněné síťoviny na každou stranu spáry. Do hmoty se následně vtláčí pás skleněné síťoviny. Přbytek stěrkové hmoty, prostoupený oky skleněné síťoviny, se zarovná hladítkem. Skleněná síťovina nesmí prostupovat stěrkovou hmotou.
- 5.4 Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se napojují s přesahem minimálně 100 mm.

6. Kladení nášlapné vrstvy

- 6.1 Nášlapnou vrstvu lze klást po dokončení předchozích operací, nejdříve však po 24 hodinách.
- 6.2 Doporučené jsou např. dlažba, laminátové a dřevěné nášlapné vrstvy. Nevhodné jsou např. zátěžové koberce a jiné materiály, které nezajistí minimální roznesení napětí do spodních vrstev podlahy.
- 6.3 Podlahu je možné doplnit i o elektrické podlahové rohože, případně topné fólie.
- 6.4 Nášlapná vrstva se klade dle příslušného technologického postupu na očištěný povrch desek, zbavený zbytků lepidel a použitých hmot.
- 6.5 Dlažbu doporučujeme lepit flexibilním lepidlem, například BETAFIX[®] SF.

7. Přeprava a skladování

- 7.1 Materiály a hmoty musejí přepravovat a skladovat v původních obalech. Při skladování musí být dodržována lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.
- 7.2 Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a spárovací hmoty dodané v suchém stavu se skladují v původních obalech v suchém prostředí na dřevěném roštu, paletě.
- 7.3 Penetrační nátěry a základní barvy se skladují v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.
- 7.4 Desky S-BOARD se skladují v suchém prostředí uložené naplocho na rovné podložce. Musejí být chráněny před mechanickým poškozením, UV zářením a působením organických rozpouštědel.
- 7.5 Lišty a profily se skladují uložené podélně na rovné podložce. PVC profily a profily s integrovanou skleněnou síťovinou se musí zajistit ochrana před UV zářením.

8. Nakládání s odpady

- 8.1 Likvidace nepoužitých zbytků hmot se provádí dle příslušných bezpečnostních listů jednotlivých hmot.
- 8.2 Zbytky hmot na bázi cementu se likvidují zakropením vodou a po vytvrzení se deponují jako ostatní odpad (170101 - Beton).
- 8.3 Obaly suchých hmot na bázi cementu se likvidují jako ostatní odpad (150101 – Papírové a lepenkové obaly).
- 8.4 Nepoužitá zbytky desek S-BOARD se likvidují jako ostatní odpad (170604 – Izolační materiál).
- 8.5 Zbytky plastových lišt se skleněnou síťovinou a skleněná síťovina, těsnící a lepicí pásy se likvidují jako ostatní odpad (170904 – Směsné stavební a demoliční odpady).

Příloha 1 – Příprava podkladu

..... www.stomix.cz

POKYNY PRO MONTÁŽ

S-BOARD FLOOR

 Aktuální informace naleznete na
www.stomix.cz

Stav podkladu	Navrhované opatření
Rovinnost podkladu	Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou hmotou zajišťující požadovanou přídržnost k podkladu resp. soudržnost podkladu.
Nesoudržný podklad	Mechanické odstranění nesoudržných částí podkladu s případným předchozím zvlhčením podkladu, následně místní nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodnou hmotou s požadovanou přídržností k podkladu.
Mastný podklad	Omytí teplou tlakovou vodou s přidavkem saponátu, případně omytí tlakovou párou. Podklad musí před prováděním dalších operací řádně vyschnout.
Znečištění odbedňovacími a jinými separačními prostředky	Odstranění znečištění vodní párou s použitím čistících prostředků, omytí čistou tlakovou vodou.
Bioticky napadený podklad (mech, řasy, lišejník, plísňe aj.)	Ošetření přípravkem na likvidaci biotického napadení (dle příslušného návodu). Mechanické odstranění zbytků po napadení, očištění povrchu od nečistot. Omytí tlakovou vodou.
Výkvěty na vyschlém podkladu	Mechanické odstranění, ometení, omytí tlakovou vodou
Zaprášený podklad	Ometení nebo omytí tlakovou vodou.
Neaktivní trhliny	Utěsnit vhodnou hmotou.
Aktivní trhliny	Další operace neprovádět do odeznění příčin. Případně příčiny sanovat vhodným opatřením.
Vlhký podklad (např. zemní vlhkost)	Na základě analýzy sanovat příčiny vlhkosti vhodným opatřením a nechat vyschnout, případně pouze nechat vyschnout. Další operace provádět až po dosažení rovnovážné vlhkosti dle platných norem (např. ČSN 73 0540)
Sprašující podklad	Mechanické odstranění nátěrů a omítek oškrábáním, otloučením pokud lze provést. Napuštění podkladu vhodnou penetrační hmotou. Před provedením následujících operací ověření přídržnosti aplikovaných hmot k podkladu dle požadavků na přídržnost k podkladu.
Nestejnorodost podkladu, přílišná savost	Napuštění podkladu odpovídající penetrační nátěrovou hmotou.